

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2023-019

深圳市民德电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156,940,611 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	民德电子	股票代码	300656
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高健	陈国兵	
办公地址	深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号	深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号	
传真	0755-86022683	0755-86022683	
电话	0755-86329828	0755-86329828	
电子信箱	ir@mindeo.cn	ir@mindeo.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务和产品

报告期内，公司主要从事条码识别设备的研发、生产和销售业务，以及半导体设计和分销业务。

1、条码识别业务

公司条码识别主要产品包括用于一维码、二维码信息识别和读取的手持式条码扫描器、固定式 POS 扫描器、固定式工业类扫描器等系列识读设备，目前被广泛应用于零售、物流、仓储、医疗健康、工业制造和电子商务等产业的信息化管理领域。

此外，基于公司条码识别技术，公司亦涉足物流自动化产品领域，为快递物流企业提供自动化设备产品和技术服务。

2、半导体设计和分销业务

公司半导体设计和分销业务包含两项子业务：

(1) 功率半导体设计业务：公司功率半导体设计业务主要产品包括 MOS 场效应二极管（MFER）、分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）、超级结 MOSFET、快恢复二极管（FRD）等，主要应用在光伏逆变、储能、电源适配器、工业 PFC 等场景。

(2) 电子元器件分销业务：公司电子元器件代理分销业务以被动元器件（电容、电阻、电感、滤波器等）分销为主，并延伸至新能源动力和储能电池业务，下游主要覆盖汽车电子、移动通讯设备、云数据存储、无人机等领域的行业领先客户以及各类储能市场客户。

(二) 公司经营模式

公司主要业务经营模式如下：

1、条码识别业务

公司从事于条码识别技术和相关产品的自主研发工作，并采取自主设计、委外加工、自主总装及测试的模式进行条码识读设备及扫描引擎等核心模组产品的生产制造。公司的产品主要通过直销和经销相结合的方式，销往下游设备制造、集成商和终端用户。

2、半导体设计和分销业务

(1) 功率半导体设计业务

控股子公司广微集成公司主要从事功率半导体器件的自主研发设计工作，并与代工厂合作开发特色工艺生产平台，采取代工生产的模式进行功率半导体器件的生产制造。产品通过直销和分销相结合的方式，销往下游芯片封测厂、分销商和终端客户。

(2) 电子元器件分销业务

全资子公司泰博迅睿公司主要从事电子元器件分销业务，其主要经营模式：向上游电子元器件制造商原厂购入各类规格型号的电子器件，并通过自身的分销渠道，为下游各个领域的行业领先客户提供其研发、生产所需的各种电子器件及相应解决方案。泰博迅睿公司所代理分销产品以被动元器件为主，并逐步拓展主动元器件系列产品。

此外，泰博迅睿公司基于现有业务资源，开拓新能源动力和储能电池业务，上游与电池厂商建立长期业务合作，为下游各类市场客户提供动力和储能电池产品及相应解决方案。

(三) 公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、条码识别业务

条码识别技术作为最常见的自动识别技术之一，具有成本低、采集速度快、可靠性高等特点。近年来，我国经济快速增长、信息化和电子商务业务快速发展，以及商品和货物的快速流通，为条码识别技术的应用提供了广阔的市场基础；随着我国信息化建设、物联网、移动支付技术的进一步推进，以及条码识别技术在工业自动化领域应用的不断渗透，条码识别设备将迎来更加广阔的市场空间。

公司是中国首家实现独立自主研发条码识别设备的科技企业，经过不断技术更新迭代，目前已构建从一维码到二维码、从手持式主动扫描设备到被动式扫描平台设备、从微型扫描引擎到各类成品设备的完整产品体系，产品在解码能力、识读景深、扫描速度等技术性能上已达到或接近国际领先企业水平，是唯一一家自主研发基于激光扫描技术和基于影像扫描技术微型扫描引擎的民族企业，并不断加大对国际品牌产品的进口替代。

2、半导体设计和分销业务

半导体产业作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。半导体产业呈现较强周期性，且与经济增长和技术升级的周期关系紧密。2022 年，在全球地缘贸易关系持续紧张、消费市场需求低迷等情况下，全球半导体市场增长乏力，根据美国半导体行业协会（SIA）发布的数据，2022 年全球半导体销售额为 5,735 亿美元，较 2021 年的 5,559 亿美元增长 3.20%。未来，随着汽车电子、工业自动化、人工智能、5G 等技术加速发展，从中长期看，半导体市场的发展前景依然广阔。我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景，2022 年我国的半导体销售额为 1,803 亿美元，仍然是全球最大的芯片消费市场，具有推动集成电路产业发展的战略性优势，特别是在“碳达峰、碳中和”大背景下，未来我国的半导体市场需求也将持续增长。

功率半导体是电力电子装置电能转换与电路控制的核心，本质上，是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能，来实现变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等，并兼具节能效用。功率半导体作为不可替代的基础性产品，被广泛应用于移动通信、消费电子、汽车电子、轨道交通、工业控制、发电与配电等电力电子领域。根据 Omda 数据显示，2022 年全球功率半导体市场规模将达 481 亿美元，预计 2024 年市场规模将达到 532.19 亿美元；

2022 年中国功率半导体市场规模将达 191 亿美元，预计 2024 年市场规模将达到 195.22 亿美元，占全球市场约为 36.68%，中国作为全球最大的功率半导体消费国，未来发展前景良好。

然而，我国功率半导体器件国产化率仍处于相对较低水平，尤其在中高端产品领域国际厂商仍占据较大份额，进口替代市场空间广阔。近年来，经过国家大力的政策扶持和国产厂商努力，国产功率半导体企业发展已取得了长足进步，但与国外品牌企业相比仍存在较大差距，国产功率半导体市场尚未形成稳定的竞争格局。伴随国内功率半导体厂商的不断进步，中国市场有望涌现一批世界级的功率半导体企业。

2018 年 6 月，公司全资收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，进驻半导体电子元器件分销行业。泰博迅睿公司致力于构建差异化电子元器件分销业务优势，与汽车电子、物联网、新能源等战略新兴产业的龙头企业陆续建立稳定合作，并通过对该等行业内优质客户的服务，泰博迅睿公司进一步扩大了自身在上游原厂和下游市场的影响力。此外，泰博迅睿基于现有业务资源，开拓新能源动力和储能电池业务，上游与电池厂商建立长期业务合作，为下游各类市场客户提供动力和储能电池产品及相应解决方案。

2020 年 6 月，公司控股收购广微集成技术（深圳）有限公司，进入功率半导体设计行业。广微集成公司处于快速成长期，产品获得多家品牌终端客户批量验证，是国内功率半导体设计企业中较少可提供 45V-150V 全系列 MOS 场效应二极管（MFER）产品的企业，且是国内少数在 12 英寸晶圆厂成功量产分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）的企业。广微集成公司新产品、新技术储备丰富。

此外，公司致力于构建功率半导体 smart IDM 生态圈，先后投资布局功率半导体上游核心环节：晶圆原材料（晶睿电子）、晶圆代工（广芯微电子）、超薄背道代工（芯微泰克），为公司功率半导体产业长远发展构建深厚的护城河。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☒否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,532,569,199.94	831,666,633.06	84.28%	810,467,730.74
归属于上市公司股东的净资产	1,145,453,780.08	556,235,179.65	105.93%	534,678,201.52
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	518,197,303.02	546,284,194.43	-5.14%	403,210,033.23
归属于上市公司股东的净利润	89,709,237.83	76,133,587.26	17.83%	51,603,058.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,557,568.35	48,768,860.40	7.77%	14,275,296.08
经营活动产生的现金流量净额	78,696,244.80	47,732,424.16	64.87%	19,604,589.25
基本每股收益（元/股）	0.5750	0.5296	8.57%	0.3590
稀释每股收益（元/股）	0.5750	0.5296	8.57%	0.3590
加权平均净资产收益率	8.49%	13.98%	降低 5.49 个百分点	10.02%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,163,087.56	115,986,180.23	157,953,976.73	156,094,058.50
归属于上市公司股东的净利润	13,803,289.84	18,373,384.00	20,002,072.72	37,530,491.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,559,778.68	16,836,769.14	18,514,786.69	5,646,233.84
经营活动产生的现金流量净额	13,526,453.39	31,991,139.16	-1,848,729.90	35,027,382.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,241	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
许香灿	境内自然人	13.18%	20,689,943.00	3,448,324.00	质押	6,758,400.00			
许文焕	境内自然人	12.40%	19,462,137.00	3,243,689.00	质押	7,402,240.00			
易仰卿	境内自然人	9.51%	14,924,519.00	2,487,420.00	质押	4,240,000.00			
黄效东	境内自然人	8.52%	13,372,552.00	2,228,759.00	质押	1,160,000.00			
新大陆数字技术股份有限公司	境内非国有法人	6.80%	10,673,288.00	1,778,881.00					
黄强	境内自然人	4.79%	7,515,923.00	986,054.00					
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	4.52%	7,087,487.00	6,037,587.00					
罗源熊	境内自然人	2.72%	4,261,975.00	710,329.00				1,284,000.00	
谢刚	境内自然人	2.22%	3,490,462.00	581,744.00					
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.09%	3,277,643.00	546,274.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明		许香灿先生和许文焕先生系父子关系，合计持有公司 25.58% 的股权，为公司的控股股东和实际控制人。							

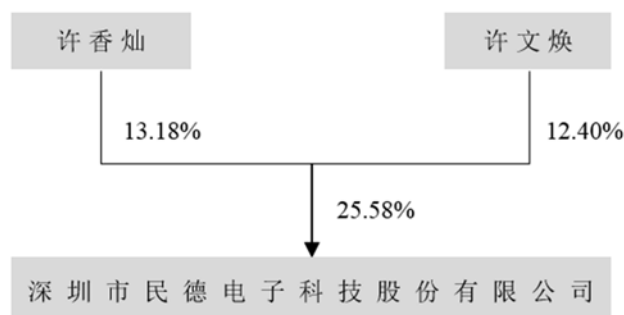
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

（一）经营情况

本报告期内，公司主营业务收入主要来源于条码识别业务和半导体业务。报告期内，公司实现总营业收入 51,819.73 万元，较上年同期减少 2,808.69 万元，同比减少 5.14%；实现归属上市公司股东的净利润 8,970.92 万元，较上年同期增加 1,357.57 万元，同比增长 17.83%；经营活动产生的现金流净额 7,869.62 万元，较上年同期增加 3,096.38 万元，同比增长 64.87%。

报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期增加 1,357.57 万元，增长 17.83%，主要原因系：（1）报告期内，公司以 4,800 万元转让了晶睿电子的 2.0870% 股权，为公司贡献了部分利润；（2）晶睿电子产能持续快速扩张，营收及利润较 2021 年有大幅提升，公司按权益法核算的对其长期股权投资收益较上年同期大幅增加；（3）公司 2022 年上半年收到定增募集资金，利用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益较上年同期增加。

（二）功率半导体布局进展

公司致力于构建功率半导体的 smart IDM 生态圈，以晶圆代工+超薄背道代工为主干，上游获取设备、晶圆原材料、掩模版、电子气体等原料供给，下游与设计公司合作，开发出多样化的产品。本报告期内，公司进一步加强在功率半导体 smart IDM 生态圈的战略布局，2022 年 3 月，公司再次对晶圆代工企业广芯微电子增资 15,000 万元，持续加码晶圆代工环节；2022 年 7 月，公司增资 10,000 万元投资超薄背道代工企业芯微泰克，奠定公司未来全面进入中高端功率半导体器件所必需的超薄背道代工资源，与广芯微电子在技术和业务上实现协同互补。至此，自 2020 年公司收购功率半导体设计公司广微集成以来，历时近三年时间，公司完成了功率半导体产业链核心所有环节的布局。未来公司将全力支持生态圈各环节项目的建设及扩产，及早充分展现 smart IDM 生态圈的产业链协同效益。

（三）向特定对象发行股票

为实现公司功率半导体产业链自主可控，进一步巩固公司完善功率半导体 smart IDM 生态圈，提升功率半导体产业核心竞争力，公司拟通过向特定对象发行股票的方式，募集总额不超过 50,000.00 万元（含本数）的资金，用于碳化硅功率器件的研发和产业化项目、适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能的提升及技术改进项目、补充流动资金。公司于 2021 年 12 月 28 日确定本次定增发行配售对象 7 名，发行价格为 45.48 元/股，发行股票数量为 10,993,843 股，募集资金总额 499,999,979.64 元，募集资金净额 494,330,133.77 元。2022 年 1 月 21 日，新增股份在深圳证券交易所挂牌上市，此次向特定对象发行股票事项完成。报告期内，募投项目各项工作正常推进，相关的厂房建设、机电安装等工程基本完成，设备已处于安装调试阶段，预计 2023 年上半年投产通线。